



RE900-05

- Fibra dura di vetro epossido FR4 1,50 mm
- Doppia faccia 35 µm Cu
- Contatti metallizzati (PTH)
- Superficie Ni/Au chimico, rivestito con maschera di saldatura
- Circuito di adattamento per TSOP II 40, 44 (0,80 mm)
- Diametro del foro 1,00 mm
- I dati Gerber per la produzione della pasta di saldatura vengono messi a disposizione gratuitamente su richiesta
- Dimensioni 29,29 x 30,94 mm

N. modulo	Tipo	Pitch	Pin	Dimensioni (mm)
RE900-05	TSOP II	0,800 mm	40, 44	11,50 x 18,80